

公司代码：688079

公司简称：美迪凯



杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天健审[2024] 3745号”审计报告，截至2023年12月31日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2023年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43元，年末累计未分配利润为180,494,713.01元，母公司期末可供分配利润为112,421,221.13元。

2023年，公司以集中竞价方式回购股份金额为4,207,826.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

基于公司2023年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	美迪凯	688079	不适用

#### 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	华朝花	张紫霞
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号
电话	0571-56700355	0571-56700355
电子信箱	huazh@chinamdk.com	ipo@chinamdk.com



### 2 报告期公司主要业务简介

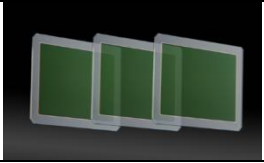


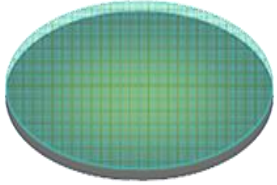
#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、智慧终端的研发、制造和销售。公司经过多年深耕，在该领域积累了丰富的经验，拥有多项核心技术。

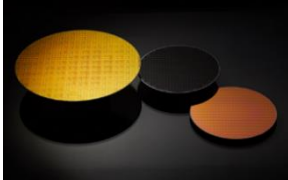

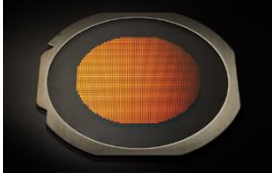

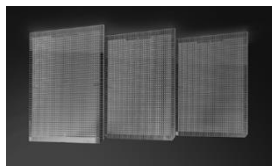

按照应用领域分类，公司主要有九大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、精密光学零部件、半导体光学、半导体封测、微纳电子、微纳光学、AR/MR、智慧终端。公司产品、解决方案广泛应用于智能手机、安防监控、机器视觉、数码相机、投影仪、智能汽车、大健康、元宇宙等领域。公司具备较强的承接国际高端光学光电子产业链业务的能力。

#### 1、半导体零部件及精密加工服务





产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
传感器陶瓷基板精密加工服务	对用于 CCD/CMOS 传感器的陶瓷基板进行超精密切割加工,应用于光学成像和生物识别领域的光学传感器		

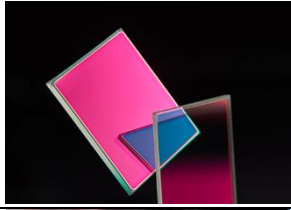

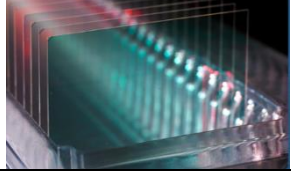

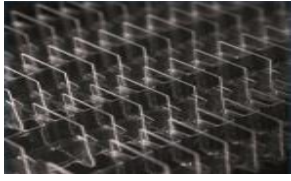

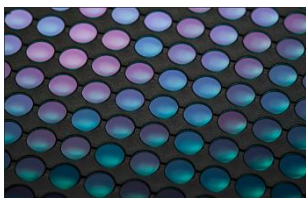

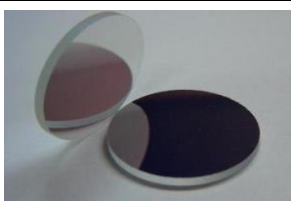
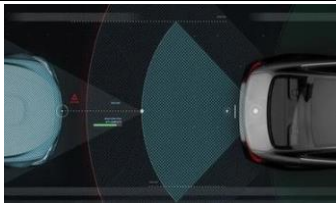
产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
传感器光学封装基板	用于 CCD/CMOS 传感器的光学镀膜封装基板, 应用于光学成像领域的光学传感器		
芯片贴附承载基板	对光学玻璃基材进行晶圆级的研磨抛光加工, 以达到高平坦度、低粗糙度要求, 最终作为生物识别芯片切割过程中的承载基板, 应用于芯片加工制程		

## 2、生物识别零部件及精密加工服务

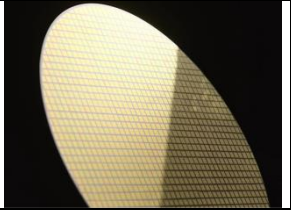

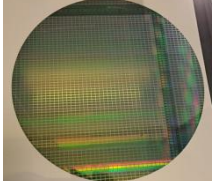
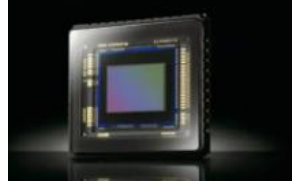
产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
半导体晶圆光学解决方案	结合半导体制程技术在芯片上进行微纳米级光学加工, 目前主要应用于新一代光学屏下指纹识别解决方案		
光学屏下指纹识别模组用滤光片	在近红外特定波段允许光信号通过, 避免光线信号干扰, 应用于光学屏下指纹识别解决方案		
3D 结构光模组用光学联结件	3D 脸部识别用点阵投影仪中透镜和光学衍射元件间的组装, 应用于脸部识别领域的光学传感器		

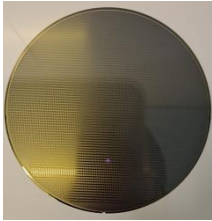

## 3、精密光学零部件

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
智能手机摄像头滤光片组立件	安装在镜座上的光学滤光片组件, 起到色差修正、还原图像真实色彩的作用, 应用于摄像头模组		
安防摄像机摄像头滤光片组立件	镜座上分别装有增透膜滤光片及红外截止膜滤光片, 通过日夜时的切换满足安防摄像机成像对不同光线场景的需求, 应用于摄像头模组		

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
光学低通滤波器	利用人造水晶的双折射特性及红外截止膜、增透膜等消除成像时的摩尔纹、色差校正、更好地还原图像真实色彩，应用于摄像头模组		
红外截止滤光片	通过红外截止膜系过滤红外波段，还原图像真实色彩，应用于摄像头模组		
光学波长板	利用产品的优异的透光率和导热性，起到透光和散热的作用，应用于各类投影仪		
吸收式涂布滤光片	通过红外吸收式油墨过滤红外波段，提高图像成像质量，应用于智能汽车等的摄像头模组		
窄带滤光片	通过光学薄膜加工工艺对特定波段起到带通且大角度偏移量小的特性，实现在信号传递过程中减少信号的损失和杂讯的干扰。		

#### 4、半导体光学

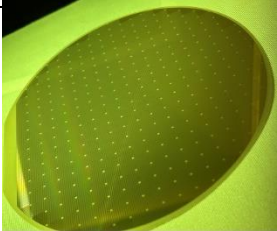

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案	通过光路层设计，结合半导体制程技术和光学成膜技术，在芯片上进行微纳米级光学加工，目前主要应用于新一代光学屏下指纹识别解决方案。		
图像传感器（CIS）整套光路层解决方案	结合半导体制程技术在芯片上进行CFA、MLA等微纳米级光学加工，目前主要应用于图像传感器（CIS）光学解决方案		

环境光传感器光路层解决方案	通过光路层设计，结合半导体制程技术和光学成膜技术，在芯片上实现整套光路层及光学矩阵的加工，主要应用于环境光传感器光学解决方案。		
---------------	---	---	---

### 5、半导体封测

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
半导体封测（射频类）	晶圆经过值球、减薄、切割、超声焊接、覆膜、塑封工艺等核心制程，产品广泛应用于通讯系统设备、移动终端设备的半导体芯片中。		
半导体封测（功率类）	晶圆经过减薄、背金、正面图形化、晶圆测试、划片、上芯、铜片贴合、塑封、切筋、测试等工艺流程，产品广泛用于新能源、储能、白色家电、快消品等领域。		

### 6、微纳电子

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
射频滤波器（SAW Filter）	通过膜层设计，结合半导体制程技术和金属成膜技术等，在衬底上进行微电路加工，目前广泛应用于通讯系统设备、移动终端设备的半导体芯片中。		

### 7、微纳光学

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图

超构表面光学器件	face ID, 智能门锁, 扫地机器人等结构光, 3D 深度感知类应用。		
散光镜	扩散压印产品, 应用于汽车 HUD 或 ToF 设备。		
MLA 镜头	应用于车载地毯透镜照明。		
晶圆光学模组	应用于医学成像镜头, ToF 设备, 光学接近传感器。		

### 8、AR/MR 光学零部件精密加工服务

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
高折射玻璃晶圆精密加工服务	对高折射率、高透过的玻璃晶圆进行加工, 实现高平坦度及高表面光滑度, 应用于 AR/MR 设备		

### 9、智慧终端

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
心电图记录仪、心率记录仪等医疗器械的 SMT 及组装	通过高精度硬件设备与独特算法相结合实时显示监测对象心电、心率、血压、脉率等生理参数数值		

## (二) 主要经营模式

### 1. 研发模式

公司始终坚持以科技（技术）创新为核心的发展战略，既有结合市场、行业发展趋势的前瞻性研究，也有针对终端产品需求的新工艺、新技术应用型开发。针对产品涉及的关键技术，依托美迪凯企业研究院下各技术中心协同开发。同时，公司与产业链上下游领先企业形成了合作研发机制，使公司能够更好地贴近客户、市场需求。另外，公司与国内多家高校院所共建合作关系，汲取多方优势共同突破行业技术难点问题。

公司依据研发流程，结合公司发展战略和市场需求由市场开发中心提出需求，设计技术中心主导进行工艺流程策划，由各个技术中心进行相应关键技术的技术攻关。为提升研发效率，采用多研发环节并行开发，各技术中心协同作业的研发方式。涉及半导体技术的开发，统一由公司半导体事业建设委员会整合相关资源实施。取得的新产品、新技术、新工艺的知识产权由科技管理中心组织申报和管理。公司基于行业特征及自身经营特点，建立了较为完备的研发体系。

### 2. 采购模式

公司建立了供应商管理、采购管理及采购流程管理制度等一套严格、完整的采购管理流程，在运营管理中心下设采购部，主要负责供应商开发、管理以及材料、设备的采购。公司根据相关产品的行业特点，确定供应链管理环境下的采购模式，通过有效地计划、组织与控制采购管理活动，按需求计划实施采购工作，具体内容为：供应商的开发与评估、采购计划的制定、实施采购。

### 3. 生产模式

公司的产品具有定制化特点，公司采取“按订单”及“按客户需求计划”相结合确定生产计划的模式，实现高效率、低成本、高弹性的生产及交付。公司对小批量产品按照客户下达的订单组织生产；对需求量大且稳定的产品，结合客户提供的产品需求计划以及实际下达的订单，进行组织生产，公司会对一些常规的半成品进行预先库存，再根据正式订单进行后续生产、发货，提高生产效率，缩短交货时间。

### 4. 销售模式

公司主要通过直销模式，为客户提供各类精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测、智慧终端等产品和服务。

公司主要的产品和服务存在定制化特点。公司成立以来坚持研发销售一体化，面向客户需求和下游市场趋势研发产品。公司客户在选择供应商时，需要对候选供应商进行较长周期的评估认证，并经过多轮的样品测试及现场稽核，全面考核候选供应商的产品质量、供货能力后，公司方能进入客户的《合格供应商名录》。

公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封装、智慧终端的研发、制造和销售。

光学光电子是结合光学、电子、计算机等的科学技术，近十年来技术突破发展迅速。当今，光电科技已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术，光学光电子产业得到前所未有的



广泛关注和大力发展。光学光电子技术是光学及电子信息技术的分支，是包含光学技术、微电子技术、材料技术、通信、计算机等多学科交叉产生的新技术。随着产品不断地推陈出新，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、能源、民生等工业，光学光电子产业已成为众所瞩目的明星产业，未来随着光电在通讯、网络、多媒体等扮演核心技术角色，光学光电子产业已变成一个国家科技实力的体现，更是一个国家综合实力的体现。

半导体行业是一个国家工业强盛必不可少的基石。半导体行业位于电子行业的中游，半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机等消费类电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能，是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体行业具有下游应用广泛、技术要求高、生产工序多、投资回报周期长、风险高等特点，全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。为加快推进我国半导体产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策，国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇。

光学光电子、半导体行业发展面临机遇，也面临挑战。随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、AR/VR 等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国光学光电子、半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球光学光电子、半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于光学光电子、半导体行业细分领域，积累了深厚的设计技术、生产工艺技术和丰富的人才资源，是该行业细分领域领先企业。公司在超精密加工、晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学半导体、半导体封测、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权，并得到国际知名客户的广泛认可。

公司通过对超薄屏下指纹芯片集成电路晶圆上的整套多层光学解决方案的开发，已具备了直接在半导体晶圆上叠加各种光学成像传输所需的整套光路层技术，拥有多项核心技术及系统级光学解决方案的能力。公司半导体晶圆制造及封测业务是公司精密光学、半导体光学技术在新产品和新应用领域的拓展，也是公司在消费电子产业链上下游产品的进一步延伸。

公司在射频前端芯片晶圆制造领域已经掌握了成熟和完整的生产工艺，并且在客户响应速度、沟通效率、物流成本上具有明显的优势，能够满足射频前端芯片领域 Fabless 厂商快速增长的代工需求。公司射频前端芯片的代工水平与国际上可比公司相比具有一定的竞争优势：第一，公司加工的晶圆尺寸更大，但晶圆 IDT 金属层厚度散差更小，体现更高的加工技术水平。第二，晶圆 IMD 绝缘层是金属导线之间的介电材料层，公司采用 PVD 蒸发二氧化硅材料，产品效果与进口 PI 胶相同，但成本更低，减少对进口材料的依赖。第三，光刻精度更高，难度更大，行业内射频前端芯片晶圆制造光刻精度一般在 200nm-1um 之间，公司的光刻精度可达到 150nm，而多数可比公司目前主要光刻精度为 180-350nm。第四，公司已掌握 ICP 干法和 Liffoff 湿法两种蚀刻方法，而多数可比公司普遍采用湿法蚀刻工艺，干法蚀刻能够满足高频射频芯片的加工要求，均匀性表现更好。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业，特别是射频芯片等通信领域的发展。工业和信息化部发布《关于推动 5G

加快发展的通知》，持续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。2021 年，工信部在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》中明确，要进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，突破一批电子元器件关键技术，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善，形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业。同年，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出丰富 5G 芯片、终端、模组、网关等产品种类，加快智能产品推广，扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。2023 年 12 月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中明确，新一代通信网络基础设施、通信设备、集成电路、新型电子元器件制造为鼓励类产业。

目前中国集成电路核心技术受制于人的现状还没有根本改变，射频前端芯片等产品仍主要依赖进口，严重影响了产业的转型升级和国家安全。射频前端芯片在手机蜂窝通信、Wi-Fi 通信、蓝牙通信、ZigBee 等无线通信领域均得到广泛使用。因不同通信领域涉及的无线频段、带宽、应用终端场景等存在差异，所对应的射频前端芯片在技术特征、材料及工艺等方面也存在一定差异。随着智能手机从 4G 向 5G 的发展、5G 向 5.5G 及 6G 的发展，单机射频前端芯片量价齐升。根据 Yole Development 数据，2023 年全球射频前端芯片市场规模约 170.65 亿美元，具有广阔的市场前景。

射频前端芯片属于技术密集型制造业，设计开发与制造工艺难度高，目前，以 Skyworks、Murata、Qualcomm、Qorvo 和 Broadcom 为代表的美国和日本企业占据了全球市场的主要份额，也掌握了该行业的核心技术和先进工艺，市场集中度高。根据 Yole Development 数据，2020 年全球前五大射频前端芯片厂商分别为 Skyworks、Murata、Qualcomm、Qorvo、Broadcom，前五大厂商合计市占率高达 85%。Skyworks、Murata、Qualcomm、Qorvo 和 Broadcom 为代表的射频前端芯片龙头企业多以 IDM 模式为主，拥有自有的晶圆制造、封装及测试厂，具备较强的产业链整合能力，可协同优化设计、制造、销售等环节，实现设计和生产一体化，有效保证设计和工艺的良好结合，确保产品性能并降低成本，同时享受全产业链产品附加值，商业模式较为成熟。

由于射频前端芯片较高的设计和工艺难度，以及国外行业龙头企业已构建的较高的知识产权壁垒，和原先国内市场主要依赖进口的产业格局，我国射频前端芯片行业整体起步较晚，技术水平与国外龙头有较大差距。整体上，国内射频前端芯片行业仍处于发展早期，行业内多数厂商主要采用“设计+晶圆代工+封测”垂直分工模式。Fabless 厂商初始投资成本较小，属于轻资产运作模式，无需承担高昂的设备费用，能快速捕捉市场热点需求并迅速推出相应产品，盈利弹性大，更适用于目前中国射频芯片产业急需突破瓶颈的现状。同时，随着我国射频前端芯片行业的发展，国内相对领先的行业内企业如卓胜微、好达电子、德清华莹、天通股份等公司也逐步尝试向 IDM 模式延伸。

从目前国内射频前端芯片的制造格局来看，国内 Fabless 企业的产能需求，主要由日本、韩国及台湾地区代工厂商完成，国内代工领域仍处于发展初期阶段，大陆地区射频前端芯片代工资源相对稀缺，国产替代的需求旺盛。随着国内射频前端芯片行业的快速发展，国内代工产能需求快速增长，且经历华为事件后，为减少境外代工环节的不确定性，其更倾向于向国内代工厂商采购。此外，适用于高频段通信的射频前端芯片广泛应用于国防、航天、军工等重要领域，射频前端芯片作为国家目前亟须发展的关键技术之一，逐步实现国产化替代已经势在必行，核心零部件的自主研发与生产对于国家重要领域的发展具有重大意义，因此，现阶段射频芯片代工领域在国内拥有巨大的市场空间。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,277,225,231.98	1,909,069,716.52	19.28	1,808,791,090.39
归属于上市公司股东的净资产	1,462,847,536.48	1,549,634,262.25	-5.60	1,577,589,377.53
营业收入	320,724,587.78	413,733,465.00	-22.48	439,467,116.86
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	306,647,149.63	404,432,141.51	-24.18	433,705,130.55
归属于上市公司股东的净利润	-84,450,948.43	22,089,138.61	-482.32	99,921,316.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,159,853.05	21,557,003.23	-448.66	91,562,645.61
经营活动产生的现金流量净额	128,188,003.34	187,221,675.45	-31.53	191,014,794.76
加权平均净资产收益率(%)	-5.60	1.42	减少7.02个百分点	7.18
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.06	-450.00	0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.06	-450.00	0.26
研发投入占营业收入的比例(%)	26.61	17.53	增加9.08个百分点	14.51

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	94,743,858.55	75,759,723.43	70,308,843.21	79,912,162.59
归属于上市公司股东的净利润	-5,176,573.18	-25,869,518.56	-34,087,788.22	-19,317,068.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	-6,018,617.04	-17,781,702.36	-31,376,970.42	-19,982,563.23

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	49,264,932.46	33,607,799.21	5,305,437.88	40,009,833.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		11,629						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		11,331						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		不适用						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		不适用						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
丽水美迪凯 投资合伙企业(有限合 伙)		165,196,355	41.16	165,196,355	165,196,355	无	0	其他
香港豐盛佳 美(國際) 投資有限公司		36,903,624	9.20	0	0	无	0	境外法人

美迪凯控股集团有限公司	1,005,441	28,634,177	7.13	27,628,736	27,628,736	无	0	境内非国有法人
景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）		19,510,584	4.86	19,510,584	19,510,584	无	0	其他
国投创新投资管理有限公司—粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）		9,885,057	2.46	0	0	无	0	其他
丽水增量投资合伙企业（有限合伙）		5,525,747	1.38	5,525,747	5,525,747	无	0	其他
丽水共享投资合伙企业（有限合伙）		2,762,874	0.69	2,762,874	2,762,874	无	0	其他
海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		2,592,404	0.65	2,592,404	2,592,404	无	0	其他
珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-401,333	2,506,795	0.62	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,912,562	1,912,562	0.48	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业，并担任其执行董事，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、丽水增量投资合伙企业（有限合伙）都是实际控制人葛文志控制的企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

**存托凭证持有人情况**

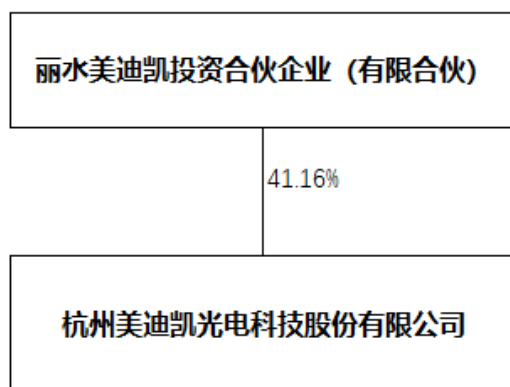
适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

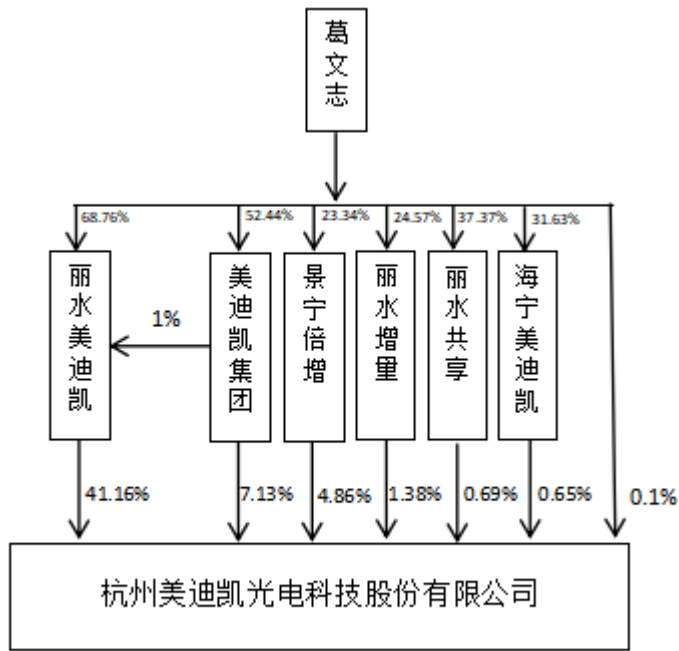
**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入 32,072.46 万元，比上年同期减少 22.48%，归属于上市公司股东的净利润 -8,445.09 万元，比上年同期减少 482.32%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用